

2024年电器芯片展会-电器芯片、传感器芯片展会-5G芯片展会-第六届国际半导体展会

产品名称	2024年电器芯片展会-电器芯片、传感器芯片展会-5G芯片展会-第六届国际半导体展会
公司名称	中国（耀瀚）展会信息
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国
联系电话	17810353883 17810353883

产品详情

2024第六届深圳国际半导体技术暨应用展览会

时间：

2024年6月26-28日

#半导体#

地点：深圳国际会展中心

展出面积：6万平米 展出企业：800家 观众预计60000人次

想象一下，你正坐在沙发上，手中拿着一个薄如纸张的高清电子书，文字清晰锐利，色彩鲜艳逼真，仿佛就是纸质书一般。这种神奇的体验离不开半导体显示技术的支持！

半导体显示技术，简单来说就是利用半导体材料制造出的显示装置。它广泛应用于各种电子设备，如智能手机、平板电脑、电视、电子书、电子游戏等。

那么，为什么半导体显示如此受欢迎呢？一是因为它能产生高质量的图像和视频，让我们享受更逼真的视觉体验；二是它的能耗低、响应速度快，使电子设备更加节能高效；三是它的厚度薄，轻量便携，方便携带和使用。

2024第六届SEMI-e 深圳国际半导体技术暨应用展览会以“芯中有算，智享未来”为主题，守正创新向上进阶。展示内容更为丰富，活动体验更加多元精彩，同时将聚合国际化资源，开设“3馆14区”，展会规模超60,000m²，预计将迎来800+企业盛装亮相，展品覆盖芯片设计、晶圆制造与封装、新型显示Mini/Micro-LED、半导体专用设备、第三代半导体、电子元器件、机器视觉与传感器等全产业链，预计吸引60,00

0+观众到场参观。除此之外，展会同期将结合行业热点推出主题活动40+，邀请近百位行业院士、企业代表、业界大咖专题jima行业前沿科技与思维，加速科研成果转换应用落地，全方位多角度推动中国半导体产业高质量发展。

展示范围1、设计、芯片、晶圆制造与封装：集成电路设计及芯片、晶圆制造、SiP先进封装、功率器件封测、MEMS封测、硅晶圆及IC封装载板、封装基板与应用制造与封测、EDA、MCU、封装基板半导体材料与设备及零部件等

2、先进材料：硅片及硅基材料、光掩模板、电子气体、光刻胶及其配套试剂、CMP抛光材料、靶材、封装基板、引线框架、键合丝、陶瓷基板、芯片粘合材料等

3、IC载板/陶瓷基板：IC载板及封装工艺(基板、铜等结构材料及干膜、金盐等化学品/耗材) Chiplet封装技术、存储、MEMS及芯片应用及材料、设备。陶瓷基板与封装材料及设备等

4、半导体显示/Mini/Micro-LED：OLED、AMOLED、Mini/Micro LED显示、柔性显示与材料及设备等

5、半导体专用设备&零部件：减薄机、单品炉、研磨机、热处理设备、光刻机、刻蚀机、离子注入设备、CVD/PVD设备、清洗设备切割机、装片机、键合机、测试机、分选机、探针台及零部件等

6、第三代半导体：氮化(GaN)和碳化硅(SiC)、氧化锌(ZnO)、金刚石、晶圆、衬底与外延、功率器件、IGBT封装材料、射频器件及加工设备等

7、元器件：无源器件、半导体分立器件/IGBT、5G核心元器件特种电子、元器件。电源管理、传感器、存储器、连接器继电器、线缆、接插器件、晶振、电阻、显示器件、二极管、三极管滤波元件、开关及元器件材料及设备等

8、机器视觉与传感器：各类感知元件、执行器、智能传感器、工业传感器、传感器芯片、传感器生产与制造设备、配件等

9：电源&储能技术：储能电源及传感器、电池管理芯片、功率半导体器件及材料和相关设备、仪器及零部件等

10、毫米波雷达/激光雷达/自动驾驶：毫米波雷达模组、射频芯片、天线及高频PCB、高频材料、生产组装设备等qiche雷达传感器上下游供应链各环节产品等

11、微电子综合智造区：电子自动化、机器自动化、视觉检测、环保、清洗设备、检测设备、测试仪器、配件等

12、AI与算力、算法、存储、CPO共封装：人工智能芯片、方案、算力芯片及方案、算法方案数据存储、光电共封装模块及技术和设备等

13、qiche半导体/车规级先进封装技术：车规级半导体主控/计算类芯片、功率半导体(IGBT和MOSFET)、车规级SiC模块、电源管理芯片、qiche电子微组装及功率器件、封装测试设备、自动化设备、国际半导体材料商、设备商、封测、制造、代工厂商等

半导体专用设备及半导体零部件是半导体不可缺少部分。为了促进深圳半导体展新发展，所以深圳第六届半导体展特设半导体专用设备及半导体零部件展区。

半导体行业的重要性不言而喻，它是各种高新技术升级的基础，渗透于各种技术领域。而中国是半导体消费大国，每年的消费量占全球消费量的三分之一，进口量则高达3,000亿美元，这一数据甚至高于中

国的原油进口量。中国对半导体行业的支持是一以贯之的，早在2015年就将包括半导体在内的若干行业列入其“中国制造2025”计划中的关键行业予以大力扶持。《国家集成电路产业发展推进纲要》则列明到2030年，集成电路产业链主要环节要达到国际先进水平，一批企业进入国际梯队。

欢迎各位新老朋友莅临指导！！！！！！